Cesta De Limpeza De Wafer Quadrada De Ptfe Suporte De Gravação De Fluoropolímero Para Semicondutores Portador Personalizado De Wafer De Silício

Número do item: PL-CP89

introdução

Otimize os processos de bancada úmida para semicondutores com nossas cestas de limpeza quadradas personalizadas de PTFE. Projetados para resistência química extrema e manuseio de alta pureza, esses portadores de fluoropolímero oferecem durabilidade e precisão superiores para processos críticos de limpeza e gravação de wafer de silício.

Saiba mais

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Gravação de Wafer de Silício	Imersão do substrato em ácidos gravadores para remover camadas superficiais ou criar texturas específicas.	Resistência excepcional a misturas de HF e ácido nítrico.
Limpeza de Células Solares	Limpeza multi-estágio de wafers fotovoltaicos quadrados de grande formato antes da dopagem ou revestimento.	Capacidade de manuseio de alto volume com quebra mínima.
Processamento de MEMS	Manuseio de sistemas microeletromecânicos durante etapas críticas de liberação química.	Ambiente de alta pureza evita contaminação microscópica.
Limpeza Ultrassônica	Uso em banhos ultrassônicos para remover partículas submicrométricas de ópticas de precisão ou componentes eletrônicos.	Propriedades de amortecimento protegem peças delicadas contra danos por vibração.
Análise de Metais Traço	Preparação e limpeza de vidraria em banhos de ácido de alta pureza para química analítica.	Mais baixa interferência de fundo possível para detecção em nível de PPB.
Manuseio de Substratos de LED	Suporte para wafers de safira ou carbeto de silício através de ciclos agressivos de limpeza e enxágue.	Confiabilidade a longo prazo em processos químicos de alta temperatura.
Armazenamento e Transporte Químico	Contenção segura de substratos sensíveis durante o trânsito entre módulos de sala limpa.	Superfícies não reativas protegem a química da superfície do wafer.
Pesquisa Laboratorial	Portador de tamanho personalizado para processamento de materiais experimentais em laboratórios universitários e de P&D.	Projeto adaptável para se adequar a configurações experimentais não padrão.

Categoria de Especificação	Detalhes do Parâmetro para PL-CP89
Identificação do Modelo	PL-CP89
Dimensões Padrão	249mm x 249mm (Configuração Quadrada)
Composição do Material	100% PTFE (Politetrafluoroetileno) de Alta Pureza
Compatibilidade Química	Universal (Exceto metais alcalinos fundidos e flúor elementar)
Faixa de Temperatura	-200°C a +260°C (-328°F a +500°F)
Método de Fabricação	Usinagem CNC completa a partir de tarugo sólido
Capacidade de Wafer	Totalmente Personalizável (Contagem e espaçamento de ranhuras variáveis)
Largura da Ranhura	Usinada com Precisão (Personalizável para a espessura do wafer)

Aplicação	Descrição	Benefício Principal
Categoria de Especificação	**Detalhes do Parâmetro para PL-CP89**	
Recursos de Drenagem	Portos de fluxo na base e laterais integrados para troca de fluido	
Opções de Alças	Disponível opção de alças de PTFE destacáveis ou integradas	
Acabamento de Superfície	Acabamento usinado liso e não poroso para evitar aprisionamento de partículas	
Conformidade	Conforme RoHS, matérias-primas de grau FDA	